

高性能双引脚同步整流芯片

产品概述

这是一款单同步同
，只，两个，分别
基二。内了

典型功率

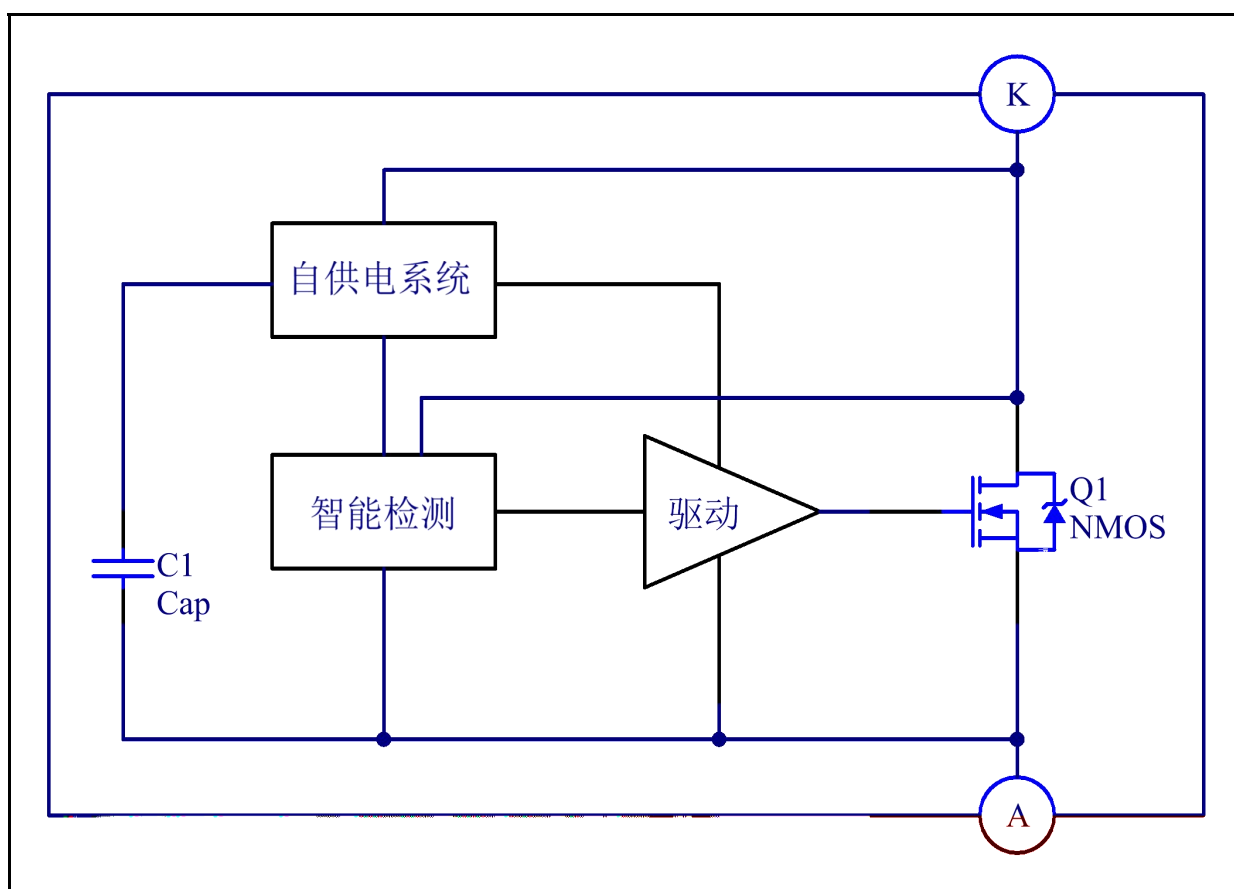
产品型号	入 压	典型功

备注:

典型功率在密闭环境 °C环境下测试

系统输出额定电流建议不超过

电路结构方框图



极限参数

参	号	值	典型值	大值	单 位
压					
大					
大 值					
功					
(到 境)					℃
(到 壳)					℃
储存 围					℃
作 围					℃
					℃

电特性参数 (℃ 除非有其他说明)

参	号	件	值	典型值	大值	单 位
压						
启动 压						
压保 值						
压保 值						
制						
压		为参 压				
关						
大						
关						
区						
大 作						

备 : . 书中 压均以 为参 ;
 . 同 会依 动 动 区 ;

功能描述

一、单、两个、同、任何外围，可以大、低传
基二、。

1. 启动

内、储、和、供、，可以、和、动、，外、。
压、于、，、供、，、内、充、，、压、上升。在、压、低于、启、
动、压、，、内、关、，、压、大于、，、内、制、始、作、，
启动、完、。、压、低、到、压、保、值、以下、，、启、。

2. 控制

到、向、压、大于、压、，、则、；
压、变化、依、压、变化、判、作、。在、，、出、前、周、
，、到、，、关、，、到、功、
减、到、，、则、关、功、。

3. 吸收电路

在、启动、出、入、压、，、在、二、体、产、压、为、内、
压、击、，、可、以、在、和、之、入、吸、，、以、减、压、。

4. 导通内阻

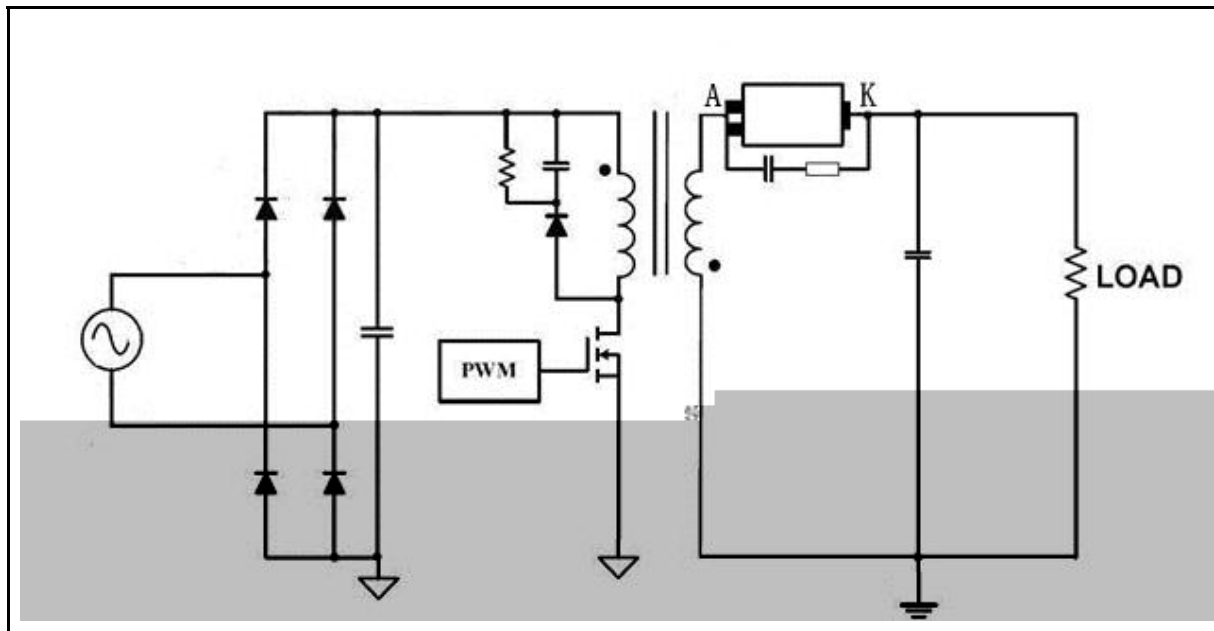
于、存在、。在、作、中、，、升、，、内、值、会、增大、，、会、低、。
可、增加、，、低、作、。

5. 注意事项

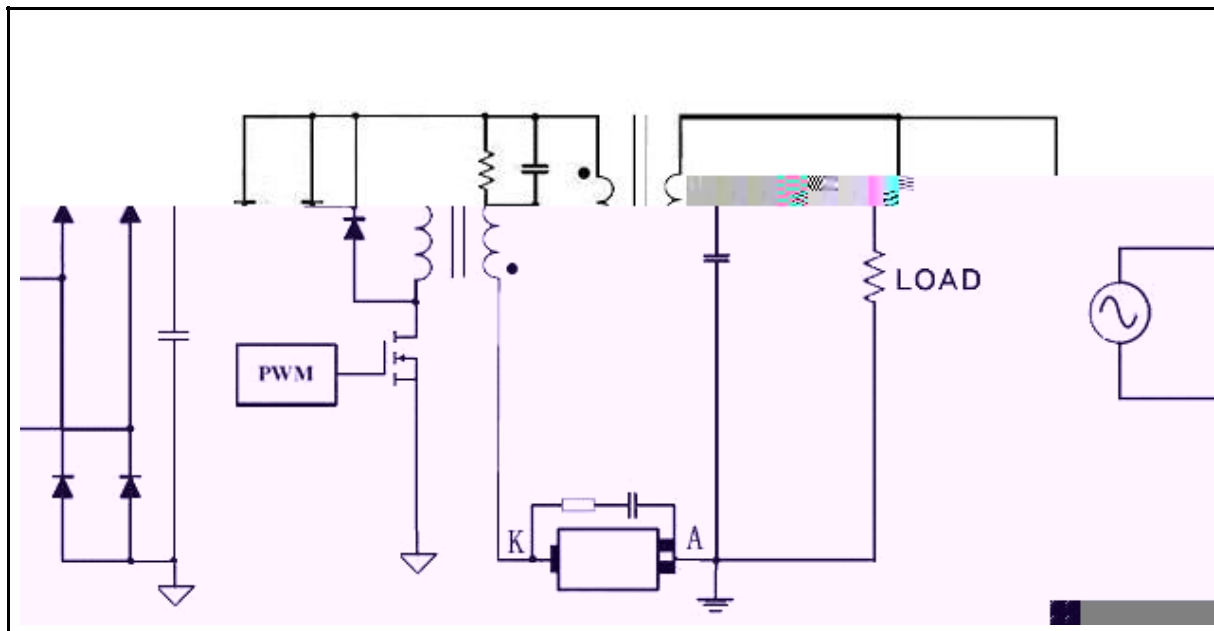
- 中、同、压、保、同、作、压、低、于、同、
压、；
- 中、同、，、估、产、品、作、境、下、否、作、。


典型应用线路图

1. 正向整流



2. 反向整流



	<p>： 产品为 元件， ! ESD 围可以 从 下 大到 备 。 可 受到 ， 因 可 元件参 不 公 。</p>
---	--

- 使 公司 产品， 在使 前仔 。
- 安 东 半 体 公 司 保 利， 不另 。
- 安 东 半 体 公 司 任 何 其 产 品 于 为 不 任 何 任 。
- 安 东 半 体 公 司 为 于 产 品 供 使 和 义 务 。
- 安 东 半 体 公 司 不 会 其 专 利 以 及 任 何 其 他 关 可 利 。
- 任 何 半 体 产 品 件 下 一 失 发 可 ， 买 任 在 使 安 东 半 体 公 司
产 品 制 安 全 准 取 安 全 ， 以 免 在 失 可 人 伤 产
失 况 发 ！
- 产 品 升 境， 公 司 为 供 优 产 品